

PlasmaTEC-X 常压等离子表面处理设备

新型设计 技术革新

产品特征:

- 安装简便
- 零电势的等离子工艺
- 处理速度快
- 数字/模拟控制信号
- 自动调整气流
- 待机节能气流控制
- 体积小，重量轻
- 输出放电控制
- Plasma REMOTE



Tantec的PlasmaTEC-X是根据常压下高压直流等离子放电原理而设计的新型表面处理设备。该设备既可以单独集成到机器人系统中，也可以集成到任一生产线上。

喷枪中的等离子需要在一定的气压下放电，释放出足够的能量，处理产品表面。无论喷枪管路是什么长度，PlasmaTEC-X主机都可以通过其内置的AirTEC系统为其源源不断的提供稳定气压，从而自动调节喷枪中的气流，所以其管路长度不影响气流的稳定性。

AirTEC系统和统一的电源输入让PlasmaTEC-X使用更加简单方便。无需任何调整，只需要连接电源和压缩空气即可使用。

一个Plasma REMOTE HMI控制器以并联模式同时控制1-8台PlasmaTEC-X主机。这些主机可以通过常规的继电器单独控制或作为一个整体，用相同的主控制器信号通过数字界面进行控制。

值得一提的是，该设备有个先进的设计——待机气流控制模式。通过HMI，操作员可以在待机状态下开关气流量，避免放电电极头吸附到灰尘。

PlasmaTEC-X主机所有连接喷嘴的接口都是标准插口，使其操作更加简单方便。基于直流放电技术和AirTEC的设计，无论喷枪管路有多长，都无需进行任何调整。

Head Office

Tantec A/S
Industrivej 6
DK-6640 Lunderskov
(+45) 7558 5822

Mail:
sales@tantec.com

Web:
www.tantec.com
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:
0512-50333890

Mobile:
13862667395

Mail:
sales@china-tantec.com

特点:

- 安装简便 仅需连接电源和压缩空气，无需调节电源和气压。
- 零电势的等离子工艺 可处理导体、非导体和半导体产品表面。
- 速度快 等离子放电能量高，可应用于高速生产线。
- 控制信号 在数字界面会显示各种不同的信号，实时控制和监控等离子放电。
- 自动调整气流 无论电源线或喷枪管路的长度有多长，主机都会自动调整，以保证提供适量的气压和气体流量。
- 待用气流 待用气流方式通过操作屏可以打开或关闭，同时避免了气源的浪费和灰尘对喷枪的影响。
- 体积小，重量轻 该特性使得PlasmaTEC-X可以很轻松地集成到几乎任一生产线上或机器人系统中。
- 输出放电控制 若输出电压低于预设值，主机会发出警报信号。
- Plasma REMOTE 该设备上的参数可以通过HMI控制器进行控制和调节。HMI控制器可以监视和控制1-8台PlasmaTEC-X。

技术参数	PlasmaTEC-X主机	PlasmaREMOTE	PlasmaTEC-X喷嘴
电源电压和频率	100-250VAC - 50/60Hz (统一的电源输入)	N/A	N/A
输出电压/功率	550VA	N/A	425watt
启动时间	10ms	N/A	N/A
关机时间	< 1ms	N/A	N/A
控制接口	M12(8帧)	M12(4帧)	N/A
规格(宽x长x高)mm	150x470x198	125x169x167	OD30x206mm
重量(kg)	6,1	2,0	1,1 (包括2m的喷枪管路)
处理宽度mm	N/A	N/A	8-14mm
压缩气体	5-6 bar, 干燥清洁	N/A	N/A
压缩气体接口	OD8mm 快速连接	N/A	N/A
气体消耗量	N/A	N/A	33ltr/min
每个PlasmaREMOTE可连接的数量	N/A	1-8台PlasmaTEC-X 主机	N/A
遵循法规	CE-RoHS-WEEE	CE-RoHS-WEEE	CE-RoHS-WEEE